

| 設備名         | メーカー      | 型式         | 能力   | 台数 |
|-------------|-----------|------------|--|----|
| 印刷機         | Panasonic | SPG        | 対応基板寸法 (mm) : Min. L50×W50<br>Max. L510×W460<br>認識カメラユニット : 1カメラでマスク側<br>(下) と基板側 (上) を認識  | 1台 |
| ボンド機        | 鈴木        | CPD-1000   | 対応基板寸法 (mm) : Min. L50×W50<br>Max. L460×W360<br>ヘッド構成 : 3ヘッド<br>塗布タクト : 0.07S  | 1台 |
| チップマウンター    | Panasonic | AM100      | 対応基板寸法 (mm) : Min. L50×W50<br>Max. L510×W460<br>タクト : 0.10S/チップ 0.295S/QFP<br>対象部品寸法 : 0402~150×25mm<br>部品の暑さ : 最大25mm 質量 : 最大<br>30g                              | 2台 |
| リフロー        | 千住金属      | SAR-825GT  | 対応基板寸法 (mm) : Min. L100×W50<br>Max. L400×W250<br>加熱部のゾーン数 : 加熱部8ゾーン (16<br>枚) ヒータ容量 : 48kw   | 1台 |
| リフロー        | 千住金属      | SNR-825GT  | 対応基板寸法 (mm) : Min. L100×W50<br>Max. L400×W250<br>加熱部のゾーン数 : 加熱部8ゾーン (16<br>枚) ヒータ容量 : 48kw<br>N2源 : 圧力0.4Mpa以上   | 1台 |
| ラジアル機       | Panasonic | RG-131-S   | 対応基板寸法 (mm) : Min. L50×W50<br>Max. L508×W381<br>挿入タクト : 約0.25S/点 (0.29、<br>0.36、0.45、0.6S の切替可能)<br>対象部品 : 2.5、5.0、7.5、10mmピッチ<br>高さ : Max. 26mm<br>直径 : Max. 18mm | 1台 |
| スプレーフラクサー装置 | 日本電熱計器    | MXL-350V型  | 低圧自動スプレーガンをスイングユニッ<br>トで幅方向に往復させ、<br>基板下面へフラックス溶剤を薄く均一な<br>膜状に塗布。  | 1台 |
| 自動はんだ付け装置   | 日本電熱計器    | ILF-350EJ型 | 液状に溶けたはんだを噴流させ、基板下<br>面にはんだ付けする。<br>はんだ量 : 400kg<br>供給窒素 : Max. 約30m <sup>3</sup> /H 0.4Mpa<br>対応基板寸法 (mm) : Min. 80 Max.<br>350                                   | 1台 |